

2024 年 11 月 7 日

NEWS RELEASE

半導体後工程自動化・標準化技術研究組合

平田機工株式会社

NEDO 公募「ポスト 5 G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（委託）」における「先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発」の採択について

平田機工株式会社（代表取締役社長執行役員：平田雄一郎、以下 平田機工）は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「ポスト 5 G 情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（委託）」において、半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（SATAS）が提案した「半導体後工程自動化・標準化の開発・実証に関する研究開発」が採択されたことを受け、本事業に参画することをお知らせします。

「半導体後工程自動化・標準化の開発・実証に関する研究開発」では、後工程の完全自動化に必要な各装置間の物理的・論理的な業界標準インタフェースの仕様を作成し、その仕様に従った装置の開発と実装ならびに単体試験を実施、各装置を統合したパイロットラインでの結合試験や動作検証を経て、パイロットライン全体としてのエネルギー生産性改善に資する研究開発を行います。この標準インタフェースと自動化技術が実現すれば、半導体後工程の生産プロセスに並列処理の概念を取り入れることにより、多様な SoC（System on a Chip）技術に対応した柔軟性の高い後工程の完全自動化ラインを構築することが可能となります。

平田機工は、SATAS の「自動搬送・保管システム」、「ロードポート & フロントエンドモジュール」および「搬送用メインフレーム」に関する分野において、半導体後工程の自動化に必要な技術の開発、共同検証、標準化等の活動に貢献します。

詳細につきましては、下記のウェブサイトをご覧ください。

○経済産業省 Web サイト：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/post5g/20241106.html

○NEDO Web サイト：

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100330.html

○SATAS Web サイト：

https://satas-cip.jp/nedo_accept202411/

【ニュースリリースに関するお問い合わせ先】

平田機工株式会社 管理本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL:096-272-5558

Mail:hirata.info@hirata.co.jp